

活化剂 T606

产品简介

T606 为低酸性盐基胶体钯活化剂，这种新型活化剂胶体粒子可以渗入微孔并被均匀的吸附在非导体的表面上。为后续的化学镀铜提供充足有效的催化活性核心，广泛应用于双面及多层印制板的孔金属化工艺及塑料镀活化工艺。

操作条件

T605	240g/L (220—240g/L)
盐酸 (37%)	4% (3—5%) (V/V)
T606	1.6% (1.2%—2.0%) (钯含量为 20—40ppm)
温 度	38—42℃
处理时间	4—7min
酸当量浓度	0.6—1.0N
比 重	1.12—1.16
搅 拌	摆动及过滤循环 (5—10 微米聚丙烯滤芯)
加 热 器	石英或铁氟龙
振动装置	振动马达 (建议功率 30—60W)
槽体材质	PP 或 PE

配 槽 (100L)

1. 将 50L 纯水放入槽。
2. 在搅拌情况下加入 T605 24kg。
3. 加入 37% 试剂盐酸 4L，加水至 100L，最后加 1.6L T606，搅拌均匀。

槽液维护

1. 据处理量补加：每处理 100 m²，需加入 400—500ml T606。
2. 每天分析补加各含量一次：
T606 浓度每提高 1%，需加入 10ml/L 的 T606；
酸浓度提高 0.1N，需加入 37% 试剂级盐酸 7.93ml/L；
3. 当溶液中铜含量达到 1g/L 时更换全部槽液。

安全措施

使用时请用安全眼镜,保护手套及安全衣;如不慎溅到身体上时,立刻用水冲洗 5-10 分钟,如感不适,请即刻就医。